

レベリング性に優れ、ピットが生じにくい装飾用硫酸銅めっき添加剤

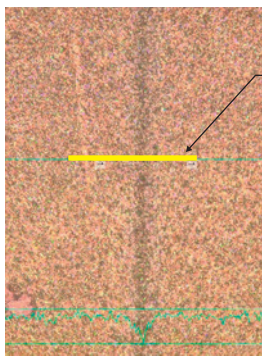
Additive for Acid Copper Plating with High Leveling Power, Can Reduce Pit

TOP DuNC CU

- 素材キズの埋め込み性に優れ、美しい外観が得られる
Can cover dent areas finely, can get beautiful appearance
- スラッジ発生量が少ない
Reduce sludge amount
- ピットを生じにくい
Can reduce pit
- 浴管理が容易
Easy bath control

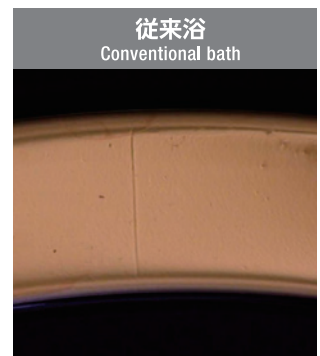
優れたレベリング性

Excellent leveling power



深さプロファイル測定箇所
Depth profile measuring spot
Rz : 2.518 μ m (最大深さ)
Maximum depth

硫酸銅めっき
Acid copper plating

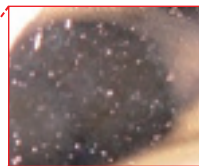
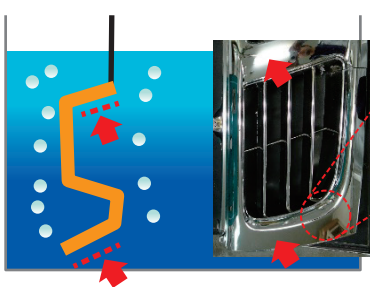


ABS成形品のウェルド部デプスプロファイル(エッチング18分)
Molded ABS resin, weld-part depth profile (Etching: 18 min)

素材キズをレベリングし、美しい外観を実現
Can cover weld part finely, can get beautiful appearance

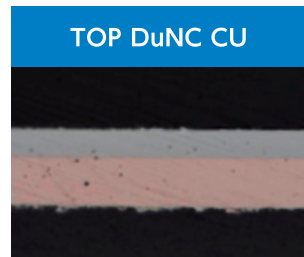
ピットを生じにくい

Prevent pit



従来品:ピットを生じやすい
Conventional bath: cause pit easily

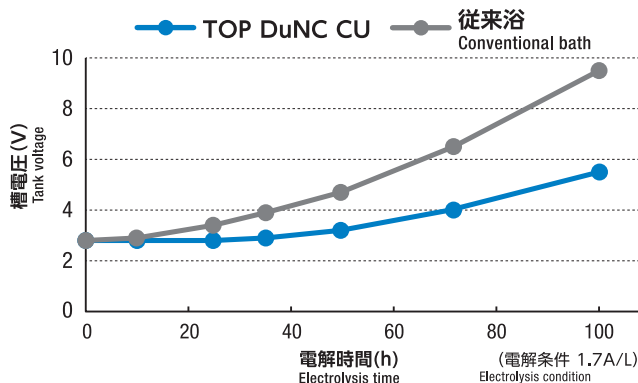
----- エア攪拌が弱く、電流密度が高くなる
Weak air agitation, high current density



ピットを防ぎ、外観が向上
Prevent pit, improve appearance

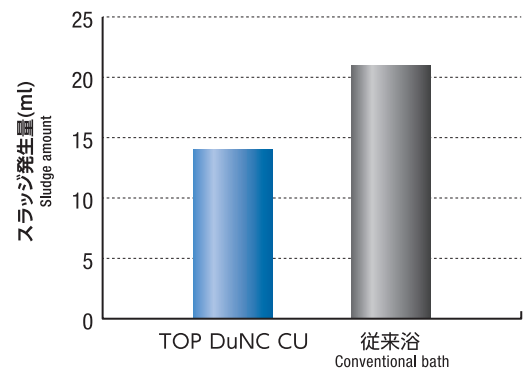
槽電圧の上昇を抑え、スラッジの発生を抑制する

Can stop tank voltage increase, prevent sludge occurrence



電解とともに槽電圧の変化
Tank voltage change by electrolysis

100時間後のスラッジ発生量をメスシリンダーで測定
Measure sludge amount after 100 hour test



スラッジ発生量の比較
Comparison of sludge amount